

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 17 年 3 月 3 日 (2005.3.3)

【公表番号】特表 2004-511107 (P2004-511107A)
 【公表日】平成 16 年 4 月 8 日 (2004.4.8)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-014
 【出願番号】特願 2002-533421 (P2002-533421)
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 5 K 9/00

【F I】

H 0 5 K 9/00 G

【手続補正書】

【提出日】平成 15 年 4 月 8 日 (2003.4.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

干渉放射線に対して遮蔽物で遮蔽された印刷回路を備え、少なくとも 1 つの電子的構成要素を有する基板の製造方法であって、

e) 前記印刷回路 (12) を備えた前記基板 (11) 上の前記少なくとも 1 つの電子的構成要素 (14) 用の接触点 (15) に、および、遮蔽物 (20) 用のアース (13) に流動性導電性固着剤 (16) を塗布するステップと、

f) 前記印刷回路 (12) を備えた前記基板 (11) に関して前記接触点 (15) 上に前記少なくとも 1 つの電子的構成要素 (14) を位置決めするステップと、

g) 前記印刷回路 (12) を備えた前記基板 (11) の前記アース上で前記少なくとも 1 つの電子的構成要素 (14) の頂部を覆う、事前形成された金属化プラスチックフィルム (30) を含む遮蔽物 (20) を位置決めするステップと、

h) 前記流動性導電性固着剤 (16) の流動点を越えて温度を上昇させることにより、前記接触点 (15) 上に前記少なくとも 1 つの電子的構成要素 (14) を、かつ前記アース上に前記遮蔽物 (20) を同時に固着するステップとを含む方法。

【請求項 2】

前記遮蔽物 (20) が、実質的に箱型の要素 (22) を含み、その側壁 (26) には前記基板 (11) の主表面に平行に延在する固着用縁部 (28) が設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記ステップ b) および c) が、いわゆるピックアップブレースデバイスを使用して行われることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の方法。

【請求項 4】

前記ステップ b) および c) が、同じピックアップブレースデバイスを使用して行われることを特徴とする請求項 3 に記載の方法。

【請求項 5】

前記金属化プラスチックフィルム (30) のプラスチック (34) が、ポリイミド、PC、PEEK、PES、ポリアミドなど、または、これらの混合物などの耐温度性材料から選択され、好ましくはポリイミドであることを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 6】

前記金属化プラスチックフィルム(30)の金属(32)が、Sn、Ni、Cu、Pb、これらの合金、および、混合物から選択されることを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 7】

前記金属(32)が、スズ、鉛、または、これらの合金を含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。

【請求項 8】

干渉放射線に対して遮蔽された印刷回路を備え、少なくとも1つの電子的構成要素を有する基板の製造方法であって、

d) 前記印刷回路(12)を備えた前記基板(11)に関して接触点(15)上に前記少なくとも1つの電子的構成要素(14)を位置決めし、かつ固着するステップと、

e) 前記印刷回路(12)を備えた前記基板(11)の前記アース(13)上に、前記電子的構成要素(14)の頂部を覆う、事前形成された金属化プラスチックフィルム(30)を含む遮蔽物(20)を位置決めするステップであって、前記遮蔽物(20)が実質的に箱型の要素(22)であり、その側壁(26)には前記基板(11)の主表面と平行に延在する固着用縁部(28)が設けられ、前記固着用縁部(28)には貫通孔(29)が設けられるステップと、

f) 固着剤を使用して、前記印刷回路を備えた前記基板(11)のアース上に遮蔽物(20)を固着するステップとを含む方法。

【請求項 9】

前記固着剤が片面接着テープ(31)であることを特徴とする請求項8に記載の方法。

【請求項 10】

前記ステップa)およびb)が、いわゆるピックアンドプレースデバイスを使用して行われることを特徴とする請求項8または9に記載の方法。

【請求項 11】

前記金属化プラスチックフィルム(30)のプラスチック(34)が、ポリイミド、PC、PEEK、PES、ポリアミドなど、または、これらの混合物などの耐温度性材料から選択され、好ましくはポリイミドであることを特徴とする請求項8から10のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 12】

前記金属化プラスチックフィルム(30)の金属(32)が、Sn、Ni、Cu、Pb、これらの合金、および、混合物から選択されることを特徴とする請求項8から11のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 13】

前記金属(32)が、スズ、鉛、または、これらの合金を含むことを特徴とする請求項12に記載の方法。